



ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Digi International stellt die neuesten IoT-Konnektivitätslösungen und Kundenanwendungen auf der Embedded World 2019 vor

Digi präsentiert ConnectCore 8X SOMs, SBCs und zugehörige Entwicklungs-Kits zusammen mit Digi XBee3 Modulen und Modems auf der wichtigsten internationalen IoT-Veranstaltung

Nürnberg, 19. Februar 2019 – Digi International®, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Internet of Things (IoT) Konnektivitätsprodukten und Dienstleistungen, gab heute bekannt, auf der [Embedded World 2019](#) die ConnectCore® 8X-Systemmodule (SOM) und Single-Board-Computer (SBC) sowie die Digi XBee3®-Serie von Modulen und Modems vorzustellen. Darüber hinaus wird Digi Demonstrationen und Informationsveranstaltungen organisieren, die den neuesten Stand der Embedded-Technologie und ihre Möglichkeiten veranschaulichen. Die Embedded World findet im Messezentrum Nürnberg vom 26. - 28. Februar 2019 statt. Digi wird seine Lösungen in Halle A3, Stand 629 ausstellen.

Auf der Veranstaltung stellt Digi die ConnectCore 8X Entwicklungskits vor, die darauf ausgelegt sind, Hard- und Softwareingenieuren, Unternehmenstechnologen, aber auch Lehrkräften und Studenten die Möglichkeit zu geben, praktische Erfahrungen bei der Integration von Konnektivität in ihre IoT-Lösungen und Anwendungen zu sammeln.

Digis ConnectCore 8X SOM und SBC, im extrem kleinen Digi SMTplus® Formfaktor, verwenden die NXP i.MX 8X Familie, die auf ARM® Cortex®-A35 und Cortex-M4F Kernen basiert. Das ConnectCore 8X System wurde für höchste Zuverlässigkeit und Designfreiheit entwickelt und bietet 2X2 MIMO 802.11ac + Bluetooth® Smart Konnektivität, Grafik-, Video-, Bildverarbeitungs-, Audio- und Sprachfunktionen sowie Digi TrustFence® Sicherheit für anspruchsvolle IoT-Anwendungen in stark regulierten Bereichen wie Medizin/Gesundheitswesen, Verkehr, Gebäudeautomatisierung, modernste Bedienoberflächen und industrielle Verwendbarkeit.

Die Digi XBee3-Serie von Smart Edge RF-Modulen und Mobilfunkmodems ist hochintegriert, kompakt und wurde zur Unterstützung von IoT-Innovationen am Rand des Netzwerks entwickelt. Mit einem modularen Ansatz für die IoT-Konnektivität ermöglicht die Digi XBee3-Serie die Integration neuer Funktionen mit MicroPython-Programmierbarkeit, Dual-Mode-

Funkmodulen und der Möglichkeit, die Firmware over-the-air (OTA) zu aktualisieren. Diese Funktionalitäten ermöglichen Flexibilität im Wireless-Design, eine kostengünstige Integration und einfach hinzugefügte kundenspezifische Geschäftslogik am Rand des Netzwerks. Das Ergebnis sind innovative IoT-Lösungen, die schneller entwickelt, prototypisiert und in Serie produziert werden können.

„Ein Großteil der IoT-Branche konzentriert sich auf Embedded-Technologie und die Embedded World ist der wichtigste Ort, um zu zeigen, was Digi International zu dem Markt beiträgt“, sagte Mike Ueland, President IoT Products and Services, Digi International. „Wir freuen uns sehr, mehrere Anwendungsfälle für unser IoT-Produktangebot herauszustellen. Wir nutzen die Embedded World als Ausgangsbasis für die Markteinführung von ConnectCore 8X, so wie wir es mit der Digi XBee3-Serie auf der letztjährigen Veranstaltung getan haben, was von der Branche sehr positiv aufgenommen wurde.“

Geplante Produktvorstellungen und Vorführungen:

- **Digi ConnectCore 8X-** Die Digi ConnectCore 8X SOM und SBC Demo am Digi-Stand mit NXP (Digi ist ein NXP Early Access Partner) und Au-Zone wird die fortschrittlichsten maschinellen Lern- und Bilderkennungsfunktionen sowie die Flexibilität des Designs hervorheben.
- **Remote-IoT-Konnektivität mit Digi XBee3 Cellular:** Digi wird seine Remote-Geräteverwaltungsfunktionen zwischen einem mit dem Digi XBee3 Cellular ausgestatteten Gerät und dem Cloud-basierten Digi Remote Manager® vorstellen, indem die Fernüberwachung und -steuerung von Geräten direkt vom Messegelände aus demonstriert werden.
- **Digi XBee3 End-to-End IoT-Netzwerk:** Digi wird die neuesten Entwicklungen der Digi XBee3-Plattform vorstellen, einschließlich Multi-Protokoll-Unterstützung (Zigbee, CAT-1, LTE-M, NB-IoT + Bluetooth LE), mit einer IoT-Netzwerklösung, die aus Digi XBee3-Modulen, Digi XBee® Industrial Gateways und Netzwerk-/Geräteverwaltungstools besteht. Diese Updates ermöglichen neue Anwendungsfälle für eine verbesserte Installation, lokale Steuerungsdiagnose und Konfiguration. Das Netzwerk- und Geräteelement nutzt eine neue XCTU® Mobile-Anwendung für die Digi XBee-Konfiguration über Bluetooth mittels Smartphone oder Tablett.
- **SteadyServ iKeg:** Diese Anwendungsdemonstration zeigt das SteadyServ iKeg mit Sensoren zur Messung des Keg-Volumens, analysiert die Daten lokal mit einem Digi XBee Industrial Gateway und sendet die Analyse dann über eine Zigbee-Verbindung in die Cloud. Die iKeg-Anwendung präsentiert den Bar-Managern die Cloud-basierten Informationen, um eine genaue Lagerbestandsführung zu ermöglichen und proaktiv mehr zu bestellen, wenn das Bier knapp wird.

Informationsveranstaltung

- Am Mittwoch, dem 27. Februar zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr Andreas Burghart, Solutions Sales Engineer bei Digi International, und Richard Elberger, globaler IoT-Partner-Lösungsarchitekt bei AWS, werden im Rahmen der Session 1.1 im Internet der Dinge-Track Gastgeber einer Informationsveranstaltung mit dem Titel „Wo die Cloud auf den Rand trifft: Fünf Grundsätze für den Erfolg am Rand“ sein. In der Informationsveranstaltung werden die Cloud- und Edge-Computing-Fähigkeiten erläutert und wie die richtige Hardware gefunden werden kann, um Intelligenz dort zu liefern, wo sie am wichtigsten ist.

MitAussteller

- Zusätzlich zum eigenen Stand wird Digi Lösungen zusammen mit anderen Unternehmen ausstellen, die ebenfalls auf der Messe vertreten sind. So stellt etwa Mouser in seiner Virtual Reality-Demonstration „Future Cities“ (Halle 3A, Stand 111), die Digi XBee XGI Industrial Gateways sowohl im Bereich „Digital Twinning“ als auch im Bereich „Smarter Edge“ vor. Digi ist auch an den Ständen von Arrow (Halle 4A, Stand 340), Atlantik Elektronik (Halle 3, Stand 141), Avnet Silica (Halle 1, Stand 370), AWS (Halle 4, Stand 568), CODICO (Halle 3, Stand 310), Digi-Key Electronics (Halle 4A, Stand 633) und NXP Semiconductors (Halle 4A, Stand 220) vertreten.

Klicken Sie hier, um zu twittern

Auf der #ew19 in Halle 3 Stand 629 präsentiert @DigiDotCom das Digi ConnectCore 8X System-On-Module und SBC sowie die Digi XBee3-Serie zur Unterstützung von #IoT Innovationen am Netzwerkrand. <https://ctt.ec/em3J3> #ConnectWithConfidence #OneDigi

Weitere Informationen über diese Messeveranstaltungen finden sie unter <https://www.digi.com/pr/ew19>

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter geschäftskritischer Machine to Machine (M2M) und Internet of Things (IoT) Verbindungslösungen und Dienstleistungen. Wir helfen unseren Kunden bei der Schaffung der nächsten Generation vernetzter Produkte und der Implementation und Verwaltung kritischer Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit, mit kompromissloser Verlässlichkeit und höchster Leistungsfähigkeit. Seit unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir unseren Kunden bei der Verbindung von mehr als 100 Millionen Dingen geholfen und die Zahl wächst ständig. Weitere Informationen erhalten Sie auf

der Website von Digi unter www.digi.com oder telefonisch unter 877-912-3444 (USA) oder 952-912-3444 (international).

Anmerkungen für Redakteure

Zur Vereinbarung eines Interviews oder eines Produktbriefings mit einem Digi-Manager während der Embedded World 2019, setzen Sie sich bitte mit Anthony Hildebrand oder John Waite unter Verwendung der nachfolgenden Angaben in Verbindung.

Medienkontakt:

Europa

Anthony Hildebrand oder John Waite

Catalyst For Content

Geschäftsstelle: +44 (0) 1753 648140

anthony@catalystforcontent.com, john@catalystforcontent.com

Nordamerika

Joseph Rigoli

LEWIS

Geschäftsstelle: +1 781-418-2400

Digi@teamlewis.com